

【表紙】

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年9月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第31期第2四半期（自 2023年4月1日 至 2023年6月30日） |
| 【会社名】 | ウインテスト株式会社 |
| 【英訳名】 | Wintest Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 姜 輝 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目2番24号 |
| 【電話番号】 | 045-317-7888（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 樋口 真康 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号 |
| 【電話番号】 | 045-317-7888（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 樋口 真康 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年8月14日に提出いたしました第31期第2四半期(自2023年4月1日至2023年6月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第3 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
 (訂正前)

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2023年4月1日～ 2023年6月30日 | 1,842,500 | 39,972,000 | 96,969 | 1,427,232 | 96,969 | 1,427,232 |

(注) 1. 当社は、当第2四半期連結会計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ96,969千円増加しております。

2. 2023年1月13日付「有価証券届出書」及び2023年1月19日付「有価証券届出書の訂正届出書」にて提出いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」については、2023年8月4日付「資金使途変更に関するお知らせ」及び2023年8月7日付「資金使途の変更についてのお知らせ」の一部訂正について、以下のとおり変更いたしました。

(1) 変更の理由

2022年末まで世界を翻弄した新型コロナ禍も一段落し、世界はウイズコロナ、アフターコロナに向かって進み始めました。当社は半導体市場成長の著しい中国、そしてそれら半導体のデザインハウスの多い台湾方面をメイン市場と捉え、新機能の充実を目的に主力検査装置の更なる競争力アップ、営業力拡大を意図し、業績の向上を目的に2023年1月13日に公表いたしましたとおり、GFA株式会社を割当先とする第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を行うことを決議し、その資金使途として、当時特に不足していた一部半導体部材の仕入れ並びに、次世代装置の開発や技術者の増強、それに伴う大阪事業所の移転増強並びに増加運転資金としてまいりました。

それらの資金充当に関し、主な変更を行う理由に関しまして、調達資金が7千万円近く減少したこと並びに、それまで半導体市場をけん引してきたテレワーク需要などが終息に向かい、2022年秋頃から顕在化してきたPCやスマートフォン、一部情報端末機器向け需要が大幅に減速し、特にPCやスマホ関連の半導体が想定以上にダブつくこととなり、顧客の設備投資が急減速したことを背景に、今般、市場戦略の見直しを行い、一部の資金使途については、削減したためとなります。

(2) 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。（変更箇所は下線で示しております。）

(変更前)

| 具体的な使途 | 金額(円) | 充当予定時期 |
|------------------------|-------------|------------------|
| 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 130,000,000 | 2023年1月～2023年10月 |
| 次世代先端システム開発費、バリエーション展開 | 100,000,000 | 2023年1月～2023年12月 |
| 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 100,000,000 | 2023年3月～2024年12月 |
| 製造工場移転増強 | 70,000,000 | 2024年3月～2025年12月 |
| その他運転資金 | 98,114,000 | 2023年1月～2024年12月 |

(変更後)

| 具体的な使途 | 金額(円) | 充当予定時期 |
|---|-------------|------------------|
| 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 70,000,000 | 2023年1月～2023年12月 |
| 次世代先端システム研究開発費 Ver.1 | 30,000,000 | 2023年1月～2023年8月 |
| 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 70,000,000 | 2023年1月～2023年8月 |
| 当社100%子会社(ウィンテスト武漢)への貸付 (拠点移転費用、資材購入、運転資金) | 120,000,000 | 2023年8月 |
| その他当社運転資金 | 140,088,200 | 2023年1月～2023年8月 |
| 合計 | 430,088,200 | |

(変更前) で予定していた装置製造に関わる部材仕入れは、2023年上半年期までの市場低迷が大きく響き、新規受注が低迷したため、製造部材在庫を見直し、減少させております。(変更前) 次世代先端システム開発関連は一部を前倒しし、バージョン1(注参照)とバージョン2(注参照)に分け、今期はバージョン1のみに集中する戦略を取り予算の縮小をします。なお、(変更前) で計画していた開発・サポート技術者の増強に関し、変更後は、規模を縮小し、若干名を補充するにとどめ、引続き、2024年度以降の予算で行うこととしております。(変更前) で計画していた、大阪工場の移転につきましては、調達予定資金が予定金額に届かなかったことで、今回の増資資金では移転が難しいと判断、2024年以降に再度計画することとし、延期といたしました。しかし、中国における顧客サポートの多様化への対応と、顧客要求への即応性ニーズが今後の当社事業へ重要になると判断し、当社100%子会社であるウィンテスト武漢の営業・サポート拠点の移転並びに、武漢工場における新規開発装置向け部材の購入他で、当社子会社への貸付を行います。(変更前) の運転資金に関しましては、想定以上の諸物価の高騰などの影響を受けて(変更後) のように増加することとなりました。

注 バージョン1 次世代信号発生器を完成させ、既存筐体に組み込み機能をアップさせたもの
バージョン2 次世代信号発生器並びに信号取り込み、筐体すべてが新開発品となる装置

(訂正後)

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2023年4月1日～ 2023年6月30日 | 1,842,500 | 39,972,000 | 96,969 | 1,427,232 | 96,969 | 1,427,232 |

(注) 1. 当社は、当第2四半期連結会計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ96,969千円増加しております。

2. 2023年5月15日付「第1四半期報告書」及び2023年9月15日付「第1四半期報告書の訂正報告書」にて提出いたしました 第一部 企業情報 第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移については、以下のとおり変更いたしました。

(1) 変更の理由

変更前の合計は、当初行使金額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の資金調達額であり、本新株予約権の行使とともに行使価額の修正が行われたことにより、資金調達額に変動が生じ、当初予定していた調達予定額が下回ったため、2023年9月15日付第31期第1四半期報告書の訂正報告書の訂正内容に再変更が生じることとなりました。

(2) 変更の内容

(変更前)

| 具体的な用途 | 金額(円) | 支出予定時期 |
|---|-------------|------------------|
| 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 70,000,000 | 2023年2月～2023年12月 |
| 次世代先端システム開発費、バリエーション展開 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 98,025,800 | 2023年2月～2023年12月 |
| 製造工場移転増強 | 70,000,000 | 2023年2月～2023年8月 |
| 製造工場移転増強 | - | 中止 |
| 当社100%子会社ウインテスト武漢への貸付(運転資金、 資材購入、拠点移転費用) | 70,000,000 | 2023年3月～7月 |
| GFA株式会社からの借入の返済 | 47,000,000 | 2023年2月 |
| その他当社運転資金 | 143,088,200 | 2023年2月～2023年8月 |
| 合計 | 498,114,000 | |

(変更後)

| 具体的な用途 | 金額(円) | 支出予定時期 |
|---|-------------|------------------|
| 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 70,000,000 | 2023年2月～2023年12月 |
| 次世代先端システム研究開発費 Ver.1 | 30,000,000 | 2023年2月～2023年12月 |
| 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 70,000,000 | 2023年2月～2023年8月 |
| 製造工場移転増強 | - | 中止 |
| 当社100%子会社ウインテスト武漢への貸付(運転資金、 資材購入、拠点移転費用) | 70,000,000 | 2023年3月～7月 |
| GFA株式会社からの借入の返済 | 47,000,000 | 2023年2月 |
| その他当社運転資金 | 143,088,200 | 2023年2月～2023年8月 |
| 合計 | 430,088,200 | |

1) 用途変更の理由及び決定時期

・GFA株式会社を割当先とする第11回新株予約権行使が完了し、調達金額が430,088,200円に確定したため、2023年6月に資金用途の見直しを行い、決定いたしました。

<次世代先端システム開発費、バリエーション展開>に関しましては、調達金額が予定額より減少したため、6月に資金用途の変更を決定いたしました。なお、「次世代先端システム開発費、バリエーション展開」は、2)に記載の理由により、「次世代先端システム研究開発費 Ver.1」に変更しております。

2) 個別の資金用途及び充当期の変更詳細

<次世代先端システム開発費、バリエーション展開>当社は、次世代検査装置WTS-9000を開発する計画で開発を進め、バリエーション展開として、開発中のWTS-9000をベースとして、先端ロジック半導体の検査装置にバリエーションを広げる計画でしたが、市場の低迷からWTS-9000に集中することとし、且つ市場の要求から、現行装置の機能アップを強く求められることも多く、また次世代装置WTS-9000の完成には時間がかかることから、現在までに完成した新型機能部品を現行装置に搭載し、WTS-577SXとして現行装置の機能アップを実現2023年10月にリリースすることを決め、開発プロジェクトをバージョン1(WTS-577SX)、バージョン2(WTS-9000)と分けることとしました。引続き2023年末まで開発は継続しますが、バージョン1では、当初充当当額である100百万円は必要としないため第31期第1四半期報告書の訂正報告書で金額の微減を行い提出いたしました。今回、あらためて、充当当額の変更を行いました。

注 バージョン1 次世代信号発生器を完成させ、既存筐体に組み込み機能をアップさせたもの
バージョン2 次世代信号発生器並びに信号取り込み、筐体すべてが新開発品となる装置